

中信证券股份有限公司
关于
中科寒武纪科技股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票
之
上市保荐书

保荐机构（主承销商）



中信证券股份有限公司
CITIC Securities Company Limited

广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇二五年十月

声 明

本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司证券发行承销实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《中科寒武纪科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书》中的含义相同。

目 录

声 明	1
目 录	2
一、发行人基本情况.....	3
二、本次向特定对象发行股票方案概要.....	9
三、本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况.....	12
四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况	13
五、保荐机构承诺事项.....	14
六、本次证券发行上市履行的决策程序.....	15
七、本次发行符合国家产业政策和板块定位的规定.....	15
八、关于发行人符合向特定对象发行股票条件及有关规定的核查.....	16
九、保荐机构对发行人持续督导工作的安排.....	25
十、保荐机构对本次股票上市的推荐结论.....	26

一、发行人基本情况

（一）发行人基本情况

截至 2025 年 6 月 30 日，公司基本情况具体如下：

公司名称	中科寒武纪科技股份有限公司
英文名称	Cambricon Technologies Corporation Limited
有限公司成立日期	2016 年 3 月 15 日
股份公司成立日期	2019 年 11 月 29 日
注册资本	41,835.0224 万元
股票上市地	上海证券交易所
A 股股票简称	寒武纪
A 股股票代码	688256.SH
法定代表人	陈天石
注册地址	北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 D 座 16 层 1601 房
办公地址	北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 D 座 5 层、11-13 层、16 层
邮政编码	100191
电话	010-83030796-8025
传真	010-83030796-8024
网址	www.cambricon.com
经营范围	技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；技术进出口、货物进出口；计算机系统服务；软件开发；销售计算机软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）发行人的主营业务、核心技术、研发水平

1、发行人主营业务

公司的主营业务是应用于各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能核心芯片的研发、设计和销售；主要产品包括云端智能芯片及板卡、智能整机、边缘智能芯片及板卡、终端智能处理器 IP 以及与上述产品的配套基础系统软件。

自 2016 年 3 月成立以来，公司快速实现了技术的产业化输出，先后推出了用于终端场景的寒武纪 1A、寒武纪 1H、寒武纪 1M 系列智能处理器；基于思元 100、思元 270、思元 290 和思元 370 芯片的云端智能加速卡系列产品；基于思元 220 芯片的边缘智能加速卡。凭借在智能芯片领域的具有竞争力的产品及良好的服务，公司智能芯片产品在更

多的行业领域实现落地，服务了更多的行业客户，在积极与大模型领域企业实现适配、合作的同时，持续在运营商、金融、互联网及其他垂直行业等领域发力，获得合作方不俗的口碑。

2、发行人核心技术

寒武纪是智能芯片领域全球知名的新兴公司，能提供云边端一体、软硬件协同、训练推理融合、具备统一生态的系列化智能芯片产品和平台化基础系统软件。产品得到了多个行业客户的认可。公司不直接从事人工智能最终应用产品的开发和销售，但对各类人工智能算法和应用场景有着深入的研究和理解，能面向市场需求研发和销售性能优越、能效出色、易于使用的智能芯片及配套系统软件产品，支撑客户便捷地开展智能算法基础研究、开发各类人工智能应用产品。

通用型智能芯片及其基础系统软件的研发需要全面掌握核心芯片与系统软件的大量关键技术，技术难度大、涉及方向广，是一个极端复杂的系统工程，其中处理器微架构与指令集两大类技术属于最底层的核心技术。公司在智能芯片领域掌握了智能处理器微架构、智能处理器指令集、SoC 芯片设计、处理器芯片功能验证、先进工艺物理设计、芯片封装设计与量产测试、硬件系统设计等七大类核心技术；在基础系统软件技术领域掌握了编程框架适配与优化、智能芯片编程语言、智能芯片编译器、智能芯片数学库、智能芯片虚拟化软件、智能芯片核心驱动、云边端一体化开发环境等七大类核心技术。

3、发行人研发水平

公司董事长、总经理陈天石博士从事人工智能和处理器芯片等相关领域工作近二十年，创办并领导公司跻身全球智能芯片公司前列。发行人在技术研发、供应链、产品销售等方面均建立了成熟团队，核心骨干均有多年从业经验。公司核心研发人员多毕业于著名高校或科研院所，拥有计算机、微电子等相关专业的学历背景，多名骨干成员拥有知名半导体公司多年的工作经历。截至 2025 年 6 月 30 日，公司员工中有 77.95%为研发人员，80.18%的研发人员拥有硕士及以上学位，研发队伍结构合理、技能全面，有力支撑了公司的技术创新和产品研发。

报告期内，发行人持续地进行研发投入，以保持公司技术研发的前瞻性、领先性和核心技术的竞争优势。报告期内，发行人的研发投入情况如下：

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
研发投入	45,649.02	107,231.44	111,750.82	152,310.64

（三）主要经营和财务数据及指标

1、合并资产负债表主要数据

单位：万元

项目	2025 年 6 月 30 日	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产	729,831.03	580,031.66	564,751.69	425,515.95
非流动资产	112,180.72	91,749.59	77,051.93	151,566.21
资产总计	842,011.75	671,781.25	641,803.61	577,082.16
流动负债	125,360.05	81,813.60	46,318.10	54,214.47
非流动负债	40,372.54	46,919.70	22,532.60	28,895.61
负债合计	165,732.58	128,733.29	68,850.70	83,110.07
归属于母公司股东权益合计	675,539.77	542,265.87	564,983.88	485,489.33
所有者权益合计	676,279.16	543,047.96	572,952.91	493,972.09

2、合并利润表主要数据

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
营业收入	288,064.35	117,446.44	70,938.66	72,903.46
营业利润	103,845.28	-45,574.52	-87,580.64	-132,425.13
利润总额	103,775.46	-45,576.91	-87,473.88	-132,273.09
净利润	103,765.55	-45,692.67	-87,807.74	-132,473.65
归属于母公司股东的净利润	103,808.26	-45,233.88	-84,844.01	-125,635.31

3、合并现金流量表主要数据

单位：万元

项目	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
经营活动产生的现金流量净额	91,115.03	-161,796.02	-59,553.50	-132,986.11
投资活动产生的现金流量净额	-110,894.34	-41,165.20	42,465.91	77,713.74
筹资活动产生的现金流量净额	16,479.45	4,789.08	165,689.97	9,860.09
现金及现金等价物净增加额	-3,300.67	-198,173.66	148,640.07	-45,353.61

4、主要财务指标

主要指标	2025 年 1-6 月	2024 年度	2023 年度	2022 年度
流动比率（倍）	5.82	7.09	12.19	7.85
速动比率（倍）	3.68	4.92	11.98	7.32
资产负债率（合并报表）	19.68%	19.16%	10.73%	14.40%
应收账款周转率（次）	12.93	2.48	1.01	1.17
存货周转率（次）	0.57	0.54	1.13	0.87
总资产周转率（次）	0.38	0.18	0.12	0.11
归属于母公司股东的净利润（万元）	103,808.26	-45,233.88	-84,844.01	-125,635.31
扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润（万元）	91,256.68	-86,495.15	-104,286.25	-157,926.96
综合毛利率	55.93%	56.71%	69.16%	65.76%
研发投入占营业收入的比例	15.85%	91.30%	157.53%	208.92%
每股经营活动产生的现金流量（元/股）	2.18	-3.88	-1.43	-3.32
每股净现金流量（元/股）	-0.08	-4.75	3.57	-1.13
每股收益（基本，元/股）	2.50	-1.09	-2.07	-3.14
每股收益（稀释，元/股）	2.48	-1.09	-2.07	-3.14
净资产收益率（加权，扣非前）	17.31%	-8.18%	-15.34%	-23.40%
净资产收益率（加权，扣非后）	15.22%	-15.64%	-18.85%	-29.41%

注：各项指标计算公式如下：

流动比率=流动资产/流动负债；

速动比率=（流动资产－存货）/流动负债；

资产负债率=总负债/总资产；

应收账款周转率=营业收入/应收账款期初期末平均账面价值；

存货周转率=营业成本/存货期初期末平均账面价值；

总资产周转率=营业收入/总资产期初期末平均账面价值；

综合毛利率=（营业收入－营业成本）/营业收入；

研发投入占营业收入的比例=研发投入（不含股份支付）/营业收入；

每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额；

每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额；

每股收益、净资产收益率等指标按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益计算及披露》的规定进行计算各每股指标以各期末发行人股本总额为计算基准。

（四）发行人存在的主要风险

1、对公司核心竞争力、经营稳定性及未来发展可能产生重大不利影响的因素

（1）经营风险

1) 业绩波动的风险

2022 年到 2024 年公司尚未盈利，主要原因是人工智能芯片行业呈现高投入、长周期的特征，公司需要持续保持较高强度的研发投入。截至 2025 年 6 月末，公司已经连续三个季度实现盈利，主要系公司持续拓展市场，积极助力人工智能应用落地，使得收入大幅增长。

公司通过长期的研发投入，积累了深厚的技术积淀，并实现了技术的产品化，公司产品矩阵业已形成。公司通过技术创新，保持技术的领先性、提升产品的市场竞争力。受到国际政治经济环境、行业政策、市场竞争、市场需求及研发技术产品化等综合因素的影响，公司核心技术优势转化为业绩收入存在一定不确定性和滞后性。如上述因素发生不利变动，将可能对公司经营业绩带来不利影响，存在未来业绩波动的风险。

2) 核心竞争力风险

公司所处行业为技术密集型行业。公司掌握的核心技术及公司研发水平将严重影响公司的核心竞争力。公司是目前行业内少数全面系统掌握了智能芯片及其基础系统软件研发和产品化核心技术的企业之一，公司掌握的核心技术具有一定技术壁垒，关键核心技术处于行业的领先水平。但随着人工智能应用及算法的逐步普及，智能芯片受到了多家集成电路龙头企业的重视，该领域也成为多家初创集成电路设计公司发力的重点。此外，研发项目的进程及结果的不确定性较高，公司将面临前期的研发投入难以收回、预计效益难以达到的风险。

3) 供应链稳定风险

公司采用 Fabless 模式经营，主要供应商包括 IP 授权厂商、EDA 厂商、服务器厂商、晶圆制造厂和封装测试厂等。集成电路领域专业化分工程度及技术门槛较高，部分供应商的产品或服务具有一定的稀缺性和专有性。公司及部分子公司已被列入“实体清单”，公司的供应链稳定存在一定风险。若公司供应链发生不利变化，可能对公司的经营业绩产生不利影响。

4) 客户集中度较高的风险

报告期各期，公司前五大客户的销售金额合计占营业收入比例均在 80%以上，客户集中度较高。若公司主要客户经营发生变动或者需求放缓，可能给公司业绩带来不利影响。此外，公司面临着新客户拓展的业务开发压力，如果新客户拓展情况未达到预期，亦会对公司经营业绩造成一定不利影响。

5) 行业竞争风险

近年来,随着人工智能应用及算法的逐步普及,智能芯片受到了多家集成电路龙头企业的重视,该领域也成为多家初创集成电路设计公司发力的重点。总体来看,智能芯片技术仍处于发展阶段,技术迭代速度较快,技术发展路径尚在探索中,尚未形成具有绝对优势的架构和系统生态。随着越来越多的厂商推出智能芯片产品,该领域市场竞争日趋激烈。目前,英伟达在全球智能芯片领域仍占有绝对优势。

与英伟达等集成电路行业巨头相比,公司存在一定竞争劣势。在产业链生态架构方面,公司自主研发的基础系统软件平台的生态完善程度与英伟达相比仍有一定差距;在产品落地能力方面,公司的销售网络正逐步铺开,行业应用场景落地领域正逐步拓展,业务覆盖规模及客户覆盖领域需进一步拓展。

(2) 财务风险

1) 毛利率波动风险

2022 年至 2025 年上半年,公司毛利率分别为 65.76%、69.16%、56.71%和 55.93%。公司毛利率一方面受产品组合、公司拓展新业务、产品售价、原材料及封装测试成本、生产工艺水平等因素影响,另一方面受所在行业的影响,芯片行业的综合毛利水平与国家政策调整、市场竞争程度、供应链稳定等情况高度相关。若前述因素发生变动,公司毛利率可能存在一定波动,进而影响经营成果和业绩表现。

2) 研发投入相关的财务风险

公司一直保持较高的研发投入,2022 年至 2025 年上半年,公司研发投入分别为 152,310.64 万元、111,750.82 万元、107,231.44 万元和 45,649.02 万元,报告期内累计研发投入占累计营业收入的比例为 75.90%。为保持技术先进性和市场竞争力,公司将继续保持高强度的研发投入,其可能对公司的经营成果产生较大影响。

2、对本次募投项目的实施过程或实施效果可能产生重大不利影响的因素

(1) 募集资金投资项目的风险

公司本次发行募集资金投资项目的选择是基于当前市场环境、国家产业政策以及技术发展趋势等因素做出的,募集资金投资项目经过了严谨、充分的可行性研究论证。若公司本次募投项目的技术研发方向不能顺应市场需求变化趋势、行业技术发展趋势发生

重大变化、产品技术水平无法满足客户要求，公司将面临本次募投项目的研发成果无法取得预期效果的风险。

（2）本次向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险

本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本和净资产将有所增加，而募集资金的使用和实施需要一定的时间。鉴于公司 2024 年度仍处于亏损状态，2025 年上半年末已实现连续三季度盈利，因此根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告〔2015〕31 号）等有关文件的要求，以《中科寒武纪科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》所测算，本次向特定对象发行股票可能不会导致公司每股收益被摊薄。但是一旦该部分分析的假设条件或公司经营情况发生重大变化，不能排除本次发行导致即期回报被摊薄情况的可能性，公司依然存在即期回报因本次发行而有所摊薄的风险。

3、其他风险

（1）股票价格波动风险

股票价格不仅取决于公司的经营状况，同时也受宏观政策、经济周期、通货膨胀、股票市场的供求状况、重大自然灾害的发生、投资者心理预期、市场情绪等多种因素的影响。因此，公司的股票价格存在若干不确定性，并可能因上述风险因素出现波动，直接或间接地给投资者带来投资收益的不确定性。

（2）公司存在累计未弥补亏损的风险

智能芯片行业呈现高投入、长周期的特征。芯片行业需要持续大量研发投入，唯有通过技术突破建立竞争壁垒，方能在智能芯片市场占据先机。公司持续保持对智能芯片领域高强度的研发投入。截至 2025 年 6 月末，公司已经连续三个季度实现盈利，但仍存在累计未弥补亏损。公司前期大量研发投入可能使公司未来一定期间持续存在累计未弥补亏损，进而无法进行利润分配，其将对股东的投资收益造成一定程度不利影响。

二、本次向特定对象发行股票方案概要

（一）发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行股票的种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为 1.00 元。

（二）发行方式和发行时间

本次发行全部采用向特定对象发行 A 股股票的方式进行，本次发行时间为 2025 年 9 月 22 日（T 日）。

（三）发行对象及认购方式

根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股份的发行对象最终确定为 13 名，符合《注册管理办法》《实施细则》等相关法律法规以及发行人股东大会关于本次发行相关决议的规定，均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。本次发行配售结果如下：

序号	发行对象名称	获配股数 (股)	获配金额(元)	限售期 (月)
1	广发基金管理有限公司	1,010,861	1,207,999,112.22	6
2	UBS AG	364,010	434,999,230.20	6
3	新华资产管理股份有限公司	351,458	419,999,339.16	6
4	汇添富基金管理股份有限公司	296,647	354,499,097.94	6
5	诺德基金管理有限公司	233,217	278,698,979.34	6
6	国泰海通证券股份有限公司	221,753	264,999,270.06	6
7	国信证券（香港）资产管理有限公司	184,097	219,999,596.94	6
8	博时基金管理有限公司	132,215	157,999,569.30	6
9	国投瑞银基金管理有限公司	114,307	136,599,151.14	6
10	嘉实基金管理有限公司	109,872	131,299,237.44	6
11	华商基金管理有限公司	108,868	130,099,437.36	6
12	易方达基金管理有限公司	107,225	128,136,019.50	6
13	申万宏源证券有限公司	100,416	119,999,128.32	6
合计		3,334,946	3,985,327,168.92	-

所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购本次发行的股份。

（四）定价基准日、发行价格及定价原则

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，本次向特定对象发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2025 年 9 月 18 日。本次发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%。定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总量，即不低于 1,081.32 元/股。

发行人律师对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，公司和保荐人（主承销商）根据投资者申购报价情况，并严格按照《中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请书》中确定发行价格、发行对象及获配股票的程序和规则，确定本次发行价格为 1,195.02 元/股，与发行底价的比率为 110.51%。本次发行价格的确定符合中国证监会、上海证券交易所的相关规定，符合发行人关于本次发行相关决议及《中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票发行与承销方案》（以下简称“《发行与承销方案》”）的规定。

（五）发行数量

根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股票数量为 3,334,946 股，全部采取向特定对象发行股票的方式发行，发行数量符合上市公司董事会、股东大会决议的有关规定，满足《关于同意中科寒武纪科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]1969 号）的相关要求，且发行股数超过本次《发行与承销方案》中规定的拟发行股票数量 3,685,613 股上限的 70%。

（六）募集资金规模及用途

本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 398,532.73 万元（含本数），扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	拟投资总额	拟用募集资金投资金额
1	面向大模型的芯片平台项目	290,000.00	205,427.94
2	面向大模型的软件平台项目	160,000.00	145,207.77
3	补充流动资金	48,000.00	47,897.02
合计		498,000.00	398,532.73

在上述募集资金投资项目的范围内，公司可根据项目的进度、资金需求等实际情况，对相应募集资金投资项目的投入顺序和具体金额进行适当调整。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决。

（七）限售期

本次发行完成后，发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增股本等情形所取得的股份，亦应遵守上述限售安排。

上述限售期届满后，该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定执行。法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。

（八）股票上市地点

本次向特定对象发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易。

（九）本次发行前滚存未分配利润的安排

本次发行完成后，公司本次发行前滚存的未分配利润由公司新老股东按照发行后的股份比例共同享有。

（十）本次发行决议的有效期限

本次发行相关决议的有效期为公司股东大会审议通过之日起 12 个月。

三、本次证券发行的项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况

（一）保荐代表人

彭捷，女，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会执行总经理。主要负责或参与了立讯精密、圣邦股份、朗新科技、首都在线、寒武纪、艾为电子、海光信息、平安电工等 IPO 项目，国投中鲁、立讯精密、广联达定向增发，冠城大通公开增发，冠城大通、瀛通通讯、朗新科技可转债等再融资项目及创智科技重大资产重组项目等。其在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

侯理想，男，保荐代表人，现任中信证券股份有限公司投资银行管理委员会高级副总裁。主要负责或参与了寒武纪、海光信息、爱玛科技、英利汽车、浪潮云、长扬科技等首次公开发行股票并上市项目；寒武纪、中环股份、金银河、爱玛科技、青岛双星等再融资项目；航天发展重大资产重组、中国移动和中移资本财务顾问、中网投财务顾问等并购及财务顾问项目。负责或参与了多家企业的改制辅导等工作。其在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（二）项目协办人

吴智超，男，现任中信证券投资银行管理委员会高级经理。主要参与了旷视科技科创板 IPO、特斯联 IPO、云迹科技 IPO、寒武纪再融资、意华股份再融资、安徽电信财务顾问等项目，参与了多家企业的改制辅导工作。其在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（三）项目组其他成员

项目组其他成员包括：韩煦、张书语、曹成龙、陈力。

（四）项目组联系方式

联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

邮编：100026

联系电话：010-6083 3022

四、保荐机构及其关联方与发行人及其关联方之间的利害关系及主要业务往来情况

（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、重要关联方股份情况

截至 2025 年 6 月 30 日，中信证券自营业务股票账户持有寒武纪 116,520 股股票；信用融券专户持有寒武纪 3,100 股股票；资产管理业务股票账户持有寒武纪 5,736 股股票；做市账户持有寒武纪 6,190 股股票。中信证券全资子公司合计持有寒武纪 1,466,730 股股票，控股子公司华夏基金管理有限公司管理的多支基金产品合计持有寒武纪 23,900,874 股股票。

经核查，保荐机构及其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、重要关联方股份总计不超过发行人股份的 7%。

（二）发行人或其控股股东、重要关联方持有保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份情况

除可能存在少量、正常的二级市场证券投资外，截至 2025 年 6 月 30 日，发行人或其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在其他持有保荐机构或其控股股东、实际控

制人、重要关联方股份的情形。

（三）保荐机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员拥有发行人权益、在发行人任职等情况

经核查，截至 2025 年 6 月 30 日，保荐机构指定的保荐代表人及其配偶、中信证券董事、监事、高级管理人员不存在拥有发行人权益、在发行人任职等可能影响公正履行保荐职责的情形。

（四）保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方相互提供担保或者融资等情况

经核查，截至 2025 年 6 月 30 日，保荐机构的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、实际控制人、重要关联方之间不存在相互提供异于正常商业条件的担保或者融资等情况。

（五）保荐机构与发行人之间的其他关联关系

经核查，截至 2025 年 6 月 30 日，保荐机构与发行人之间不存在可能影响保荐机构公正履行保荐职责的其他关联关系。

五、保荐机构承诺事项

（一）保荐人已按照法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的规定，对发行人及其实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序，同意推荐发行人证券发行上市，并据此出具本上市保荐书。

（二）保荐人通过尽职调查和审慎核查，承诺如下：

1、有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会、上海证券交易所有关证券发行上市的相关规定；

2、有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

3、有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

4、有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

5、保证所指定的保荐代表人及保荐人的相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

6、保证保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

7、保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

8、自愿接受中国证监会依照《证券发行上市保荐业务管理办法》采取的监管措施；

9、承诺自愿接受上海证券交易所的自律监管。

六、本次证券发行上市履行的决策程序

（一）董事会审议通过

2025 年 4 月 30 日发行人召开第二届董事会第三十一次会议，2025 年 7 月 17 日发行人召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了本次向特定对象发行股票方案，发行人董事会认为发行人具备向特定对象发行 A 股股票的条件，对本次发行股票的种类和面值、发行方式和发行时间、发行价格及定价原则、发行数量、发行对象和认购方式、限售期、上市地点、募集资金规模和用途等事项作出决议。

（二）股东大会审议通过

2025 年 5 月 21 日，发行人召开 2024 年年度股东大会，逐项审议通过了本次发行的相关议案。

综上所述，发行人已就本次证券发行履行了《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等有关法律法规、规章及规范性文件及中国证监会规定的决策程序；发行人本次发行已获得上海证券交易所审核通过，中国证监会作出了同意注册的决定。

七、本次发行符合国家产业政策和板块定位的规定

保荐机构查询了发行人主营业务及募集资金投向的相关产业政策等。经核查，本次发行满足《注册管理办法》第三十条关于符合国家产业政策和板块定位（募集资金主要

投向主业）的规定。

公司自成立以来一直专注于人工智能芯片产品的研发与技术创新，致力于打造人工智能领域的核心处理器芯片。公司的主营业务是应用于各类云服务器、边缘计算设备、终端设备中人工智能核心芯片的研发、设计和销售。发行人的主营业务和产品符合《产业结构调整指导目录（2024 年本）》《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》《“十四五”国家战略性新兴产业发展规划》等文件中集成电路的要求和导向。公司所处行业及其主营业务与国家创新驱动发展战略高度匹配。

根据《上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定》（2024 年 4 月修订），公司属于第五条中“（一）新一代信息技术领域，主要包括半导体和集成电路、电子信息、下一代信息网络、人工智能、大数据、云计算、软件、互联网、物联网和智能硬件等”列示的科技创新企业。

公司本次募投项目紧密围绕公司主营业务，包括面向大模型的芯片平台项目、面向大模型的软件平台项目以及补充流动资金。面向大模型的芯片平台项目与面向大模型的软件平台项目有利于增强公司芯片技术和产品的综合实力，提升公司软件生态的开放性和易用性及提升公司在智能芯片产业领域的长期竞争力；补充流动资金有利于满足公司营运资金需求，保障公司持续进行科技创新的能力。本次募集资金投资项目属于《十四五规划和 2035 年远景目标纲要》《数字中国建设整体布局规划》等多项政策文件支持的科技创新领域。

公司主营业务及本次募投项目不涉及产能过剩行业或限制类、淘汰类行业、高耗能、高排放行业，属于《产业结构调整指导目录（2024 年本）》“鼓励类”项目，符合国家产业政策要求，符合科创板板块定位要求。

八、关于发行人符合向特定对象发行股票条件及有关规定的核查

（一）发行人具备本次向特定对象发行股票的主体资格

发行人现持有统一社会信用代码为 91110108MA0044ED5J 的《营业执照》，根据有关部门出具的证明文件并经核查，发行人不存在根据国家现行有关法律、法规、规范性文件及发行人《公司章程》的规定而需要终止发行的情形；发行人是依法存续并在上海证券交易所上市的股份有限公司。

经核查，保荐机构认为，发行人具备相关法律、法规及规范性文件规定的申请向特

定对象发行股票的主体资格。

（二）发行人符合上市公司向特定对象发行股票的条件

1、本次发行符合《公司法》第一百四十三条的规定

发行人本次发行的股票种类与其已发行上市的股份相同，均为境内上市人民币普通股（A 股），每一股份具有同等权利；本次发行每股发行条件和发行价格相同，所有认购对象均以相同价格认购，符合该条“同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价格应当相同”的规定。

经核查，本保荐人认为：发行人本次发行符合《公司法》第一百四十三条的规定。

2、本次发行符合《公司法》第一百四十八条的规定

本次发行的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十，发行价格超过票面金额，符合该条“面额股股票的发行价格可以按票面金额，也可以超过票面金额，但不得低于票面金额”的要求。

经核查，本保荐人认为：发行人本次发行符合《公司法》第一百四十八条的规定。

3、本次发行符合《公司法》第一百五十一条的规定

发行人已召开股东大会，审议通过了《关于公司符合 2025 年度向特定对象发行股票条件的议案》及其他与本次发行相关的议案，符合该条“公司发行新股，股东会作出决议”的要求。

经核查，本保荐人认为：发行人本次发行符合《公司法》第一百五十一条的规定。

4、本次发行不存在《证券法》第九条禁止性规定的情形

发行人本次发行未采用广告、公开劝诱和变相公开方式，符合该条“非公开发行证券，不得采用广告、公开劝诱和变相公开方式”的要求。

经核查，本保荐人认为：发行人本次发行不存在《证券法》第九条禁止性规定的情形。

5、本次发行符合《证券法》第十二条的规定

发行人本次发行符合《证券法》第十二条中“上市公司发行新股，应当符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的条件，具体管理办法由国务院证券监督管理机

构规定”的规定，具体查证情况参见“八、（二）、6、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件的逐项查证”。

6、本次发行符合《注册管理办法》规定的发行条件的逐项查证

本保荐人根据《注册管理办法》的有关规定，通过尽职调查对发行人本次发行方案进行了逐项核查，认为发行人本次发行符合《注册管理办法》的相关规定。具体查证过程如下：

（1）发行人不存在《注册管理办法》第十一条的情形

本保荐人按照《保荐人尽职调查工作准则》的要求对本次向特定对象发行是否符合《注册管理办法》第十一条进行了尽职调查，查证过程包括但不限于：核查了发行人报告期内的审计报告、定期报告及其他公告文件；查阅了报告期内重大购销合同、股权投资相关资料；核查了发行人与实际控制人及其控制的其他企业的人员、资产、财务、机构和业务独立情况；核查了发行人相关三会决议和内部机构规章制度；核查了发行人本次的发行申请文件；核查发行人承诺履行情况；取得发行人相关主管部门的证明文件；对发行人及其实际控制人、董事、监事和高级管理人员进行网络搜索；核查了发行人及其实际控制人、董事、监事和高级管理人员出具的相关承诺函；核查发行人报告期内的定期报告和其他相关公告。

经尽职调查和审慎核查，核查结论如下：

本保荐人认为发行人未违反《注册管理办法》第十一条的相关规定：

1) 擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可；

经核查，发行人不存在擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认可的情形。

2) 最近一年财务报表的编制和披露在重大方面不符合企业会计准则或者相关信息披露规则的规定；最近一年财务会计报告被出具否定意见或者无法表示意见的审计报告；最近一年财务会计报告被出具保留意见的审计报告，且保留意见所涉及事项对上市公司的重大不利影响尚未消除。本次发行涉及重大资产重组的除外；

发行人 2022 年度、2023 年度和 2024 年度的财务报告均经审计，本保荐人查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，不存在上述情形。

3) 现任董事、监事和高级管理人员最近三年受到中国证监会行政处罚, 或者最近一年受到证券交易所公开谴责;

经核查, 发行人现任董事、监事和高级管理人员最近三年不存在受到中国证监会行政处罚, 或者最近一年受到证券交易所公开谴责的情形。

4) 上市公司或者其现任董事、监事和高级管理人员因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查;

经核查, 发行人及其现任董事、监事和高级管理人员不存在因涉嫌犯罪正在被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规正被中国证监会立案调查的情形。

5) 控股股东、实际控制人最近三年存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为;

经核查, 发行人控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害上市公司利益或者投资者合法权益的重大违法行为。

6) 最近三年存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。

经核查, 发行人最近三年不存在严重损害投资者合法权益或者社会公共利益的重大违法行为。

综上所述, 本保荐人认为, 发行人本次向特定对象发行符合《注册管理办法》第十一条的规定。

(2) 本次发行募集资金使用符合《注册管理办法》第十二条的规定

本保荐人按照《保荐人尽职调查工作准则》的要求对本次向特定对象发行是否符合《注册管理办法》第十二条进行了尽职调查, 查证过程包括但不限于: 核查了发行人前次证券发行相关信息披露文件和前次募集资金以来历次公告文件; 取得发行人经董事会和股东大会批准的《前次募集资金使用情况报告》及审计师出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》, 核查了前次募集资金使用进度和效益; 核查了发行人本次募集资金投资项目的可行性研究报告、董事会和股东大会讨论和决策的会议纪要文件、相关项目备案文件、项目用地相关文件等资料; 就发行人未来业务发展目标和本次募集资金投资项目实施前景, 向发行人进行了了解; 通过调查了解政府产业政策、行业发展趋势、有关产品的市场容量、同类企业对同类项目的投资情况等信息, 对本次募集资金投资项目的

市场前景进行了独立判断；核查本次募集资金投资项目是否会增加新的关联交易、产生同业竞争。

经尽职调查和审慎核查，核查结论如下：

1) 本次发行符合《注册管理办法》第十二条第（一）款的规定：符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定

公司本次募集资金用于面向大模型的芯片平台项目、面向大模型的软件平台项目和补充流动资金，募集资金投向符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定。

2) 本次发行符合《注册管理办法》第十二条第（二）款的规定：除金融类企业外，本次募集资金使用不得为持有财务性投资，不得直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司

公司为非金融类企业，公司本次募集资金全部用于面向大模型的芯片平台项目、面向大模型的软件平台项目和补充流动资金，不用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资，不直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。

3) 本次发行符合《注册管理办法》第十二条第（三）款的规定：募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性

募集资金项目实施完成后，公司不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者影响公司经营的独立性。

4) 本次发行符合《注册管理办法》第十二条第（四）款的规定：科创板上市公司发行股票募集的资金应当投资于科技创新领域的业务

公司所处的集成电路设计行业为技术密集型行业，而智能芯片作为集成电路领域新兴的方向，在集成电路和人工智能方面有着双重技术门槛。公司自成立以来一直专注于人工智能芯片产品的研发与技术创新，致力于打造人工智能领域的核心处理器芯片。公司主营业务属于科技创新领域。

公司本次募投项目紧密围绕公司主营业务，包括面向大模型的芯片平台项目、面向

大模型的软件平台项目以及补充流动资金。面向大模型的芯片平台项目与面向大模型的软件平台项目有利于增强公司芯片技术和产品的综合实力,提升公司软件生态的开放性和易用性及提升公司在智能芯片产业领域的长期竞争力;补充流动资金有利于满足公司营运资金需求,保障公司持续进行科技创新的能力。因此,本次募集资金主要投向科技创新领域。

经核查,本保荐人认为,发行人本次向特定对象发行符合《注册管理办法》第十二条的规定。

(3) 本次发行对象符合《注册管理办法》第五十五条的规定

本保荐人对本次发行对象是否符合《注册管理办法》第五十五条进行了尽职调查,查证过程包括但不限于:核查了发行人关于本次证券发行的董事会决议、股东大会决议、相关部门的审批文件等材料。

经尽职调查和审慎核查,核查结论如下:

本次向特定对象发行股票的发行对象为 13 名符合法律法规规定的特定对象,符合股东大会决议规定的条件,未超过三十五名,遵守国家的相关规定。

经核查,本保荐人认为,发行人本次向特定对象发行符合《注册管理办法》第五十五条的规定。

(4) 本次发行符合《注册管理办法》第五十六条、五十七条、五十八条、五十九条的规定

经核查本次证券发行的申请文件、发行方案、相关董事会决议和股东大会决议,本次发行的定价基准日为发行期首日,本次向特定对象发行的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。

本次发行完成后,发行对象所认购的本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起 6 个月内不得转让。

本次发行完成后至限售期满之日止,发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份,亦应遵守上述限售安排。

上述限售期届满后,该等股份的转让和交易将根据届时有效的法律法规及中国证监会、上海证券交易所的有关规定执行。法律、法规对限售期另有规定的,依其规定。

因此，本次发行价格和锁定期等安排符合《注册管理办法》第五十六条、五十七条、五十八条、五十九条规定。

(5) 本次发行不存在《注册管理办法》第八十七条的情形

本次发行前，公司的控股股东、实际控制人为陈天石博士。截至 2025 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理陈天石博士直接持有公司股份 119,530,650 股，占公司总股本的 28.57%。同时，陈天石博士是北京艾溪科技中心（有限合伙）（以下简称“艾溪合伙”）的执行事务合伙人，艾溪合伙持有公司 30,645,870 股，占公司总股本的 7.33%。陈天石博士直接持股及通过作为艾溪合伙的执行事务合伙人，合计拥有公司 35.90%的表决权。

本次发行股票数量为 3,334,946 股，本次发行不会导致公司的控制权发生变化，陈天石博士仍为发行人的控股股东、实际控制人。

经核查，本保荐人认为：发行人本次发行不存在《注册管理办法》第八十七条的情形。

7、本次发行符合《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适用意见证券期货法律适用意见第 18 号》（以下简称“《证券期货法律适用意见第 18 号》”）的相关规定

(1) 本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》第一条的规定

最近一期末，公司不存在持有金额较大（超过公司合并报表归属于母公司净资产的 30%）的财务性投资的情形。

经核查，本保荐人认为：发行人本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》第一条的规定。

(2) 本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》第二条的规定

最近三年，公司及控股股东、实际控制人不存在严重损害上市公司利益、投资者合法权益、社会公共利益的重大违法行为。

经核查，本保荐人认为：发行人本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》第二条的规定。

（3）本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》第四条的规定

1) 关于融资规模

本次发行股票数量为 3,334,946 股，符合“上市公司申请向特定对象发行股票的，拟发行的股份数量原则上不得超过本次发行前总股本的百分之三十”之规定。

2) 关于时间间隔

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具的《验资报告》（天健验〔2023〕129 号），公司前次 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金于 2023 年 4 月全部到位，本次向特定对象发行股票的董事会决议日为 2025 年 4 月 30 日，距离前次募集资金到位日已超过 18 个月，符合“上市公司申请增发、配股、向特定对象发行股票的，本次发行董事会决议日距离前次募集资金到位日原则上不得少于十八个月。前次募集资金基本使用完毕或者募集资金投向未发生变更且按计划投入的，相应间隔原则上不得少于六个月。前次募集资金包括首发、增发、配股、向特定对象发行股票，上市公司发行可转债、优先股、发行股份购买资产并配套募集资金和适用简易程序的，不适用上述规定”之规定。

为提升公司技术水平和核心竞争力，增强公司的抗风险能力，公司结合现有资金情况及未来的发展战略合理确定本次发行规模，并将募集资金用于实施本次募投项目，属于理性融资。

经核查，本保荐人认为：发行人本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》第四条关于“理性融资，合理确定融资规模”的规定。

（4）本次发行符合《证券期货法律适用意见第 18 号》第五条的规定

上市公司通过配股、发行优先股或者董事会确定发行对象的向特定对象发行股票方式募集资金的，可以将募集资金全部用于补充流动资金和偿还债务。通过其他方式募集资金的，用于补充流动资金和偿还债务的比例不得超过募集资金总额的百分之三十。对于具有轻资产、高研发投入特点的企业，补充流动资金和偿还债务超过上述比例的，应当充分论证其合理性，且超过部分原则上应当用于主营业务相关的研发投入。

根据《上海证券交易所发行上市审核规则适用指引第 6 号—轻资产、高研发投入认定标准（试行）》（以下简称“《6 号指引》”）中关于“轻资产、高研发投入”的认

定标准要求，公司具有轻资产、高研发的特点，且满足《6 号指引》第二条至第五条规定的标准。具体情况如下：

1) 公司符合《6 号指引》第二条的规定

公司作为科创板上市公司，具有轻资产、高研发投入特点，综合考虑募集资金投资项目相关研发支出，本次再融资募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例超过募集资金总额的 30%，符合《6 号指引》第二条规定。

2) 公司符合《6 号指引》第三条关于轻资产的认定标准

截至 2024 年末，公司固定资产、在建工程、土地使用权、使用权资产、长期待摊费用以及其他通过资本性支出形成的实物资产合计占总资产比重情况如下所示：

单位：万元

项目	金额	占总资产的比例
固定资产	23,142.53	3.44%
在建工程	15,022.74	2.24%
土地使用权	4,125.67	0.61%
使用权资产	1,571.07	0.23%
长期待摊费用	1,446.99	0.22%
其他通过资本性支出形成的实物资产	-	-
合计	45,309.00	6.74%

注 1：上表中长期待摊费用为属于实物资产的部分；2、合计数与明细数之和在尾数上的差异，是由四舍五入所致。

截至 2024 年末，公司固定资产、在建工程、土地使用权、使用权资产、长期待摊费用以及其他通过资本性支出形成的实物资产合计占总资产比重为 6.74%，符合《6 号指引》中第三条规定的“轻资产”认定标准，即“公司最近一年末固定资产、在建工程、土地使用权、使用权资产、长期待摊费用以及其他通过资本性支出形成的实物资产合计占总资产比重不高于 20%”。

3) 公司符合《6 号指引》第四条关于高研发投入的认定标准

2022 年度至 2024 年度，公司研发投入占营业收入比重情况如下表所示：

单位：万元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度	平均值
研发投入	107,231.44	111,750.82	152,310.64	123,764.30

营业收入	117,446.44	70,938.66	72,903.46	87,096.19
研发投入占营业收入比例	91.30%	157.53%	208.92%	142.10%
最近三年累计研发投入总额	371,292.90			

2022 年度至 2024 年度，公司最近三年平均研发投入占营业收入比例为 142.10%，超过 30%，最近三年累计研发投入总额为 371,292.90 万元。截至 2024 年末，公司研发人员共 741 人，占公司总人数比例为 75.61%。因此，公司研发投入及研发人员情况符合《6 号指引》第四条规定的“高研发投入”认定标准，即“最近三年平均研发投入占营业收入比例不低于 15%，且最近一年研发人员占当年员工总数的比例不低于 10%”。

综上所述，公司属于具有轻资产、高研发投入特点的企业，符合《6 号指引》第二条至第四条关于“轻资产、高研发”的相关规定。鉴于公司符合《6 号指引》第三条和第四条规定，因而不适用《6 号指引》第五条规定。

公司是智能芯片领域全球知名的新兴公司，科技创新需要持续进行大量的资金及人力投入，具有较高的研发投入需求，公司本次募投项目中非资本性支出的比例为 87.25%，超过 30%部分主要用于人员工资与产品试制费等，均为与主营业务相关的研发投入，具有合理性。

经核查，本保荐人认为：公司属于具有轻资产、高研发投入特点的企业，本次发行满足《证券期货法律适用意见第 18 号》第五条的规定。

（三）公司不属于《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》《关于在科创板注册制试点中对相关市场主体加强监管信息共享完善失信联合惩戒机制的意见》规定的需要惩戒的企业范围，不属于一般失信企业

经核查，根据《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》《关于在科创板注册制试点中对相关市场主体加强监管信息共享完善失信联合惩戒机制的意见》规定的需要惩戒的企业范围，公司不属于一般失信企业。

经核查，本保荐人认为，发行人符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律法规和相关证券监管部门规范性文件规定的向特定对象发行股票的实质条件。

九、保荐机构对发行人持续督导工作的安排

（一）持续督导的期间为证券上市当年剩余时间及其后 2 个完整会计年度；

（二）有充分理由确信发行人可能存在违法违规行为以及其他不当行为的，应督促发行人作出说明并限期纠正；情节严重的，应当向中国证监会、上交所报告；

（三）按照中国证监会、上交所信息披露规定，对发行人违法违规的事项发表公开声明；

（四）督导发行人有效执行并完善防止主要股东及其他关联方违规占用发行人资源的制度；

（五）督导发行人有效执行并完善防止高管人员利用职务之便损害发行人利益的内部控制制度；

（六）督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见；

（七）督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件；

（八）持续关注发行人募集资金的使用、投资项目的实施等承诺事项；

（九）持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见；

（十）中国证监会、上交所规定及保荐协议约定的其他工作。

十、保荐机构对本次股票上市的推荐结论

保荐机构通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，并与发行人、发行人律师、会计师沟通后认为：

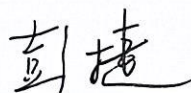
发行人本次发行符合公司整体发展战略，本次发行募集资金用于面向大模型的芯片平台项目、面向大模型的软件平台项目和补充流动资金。通过募投项目的实施，发行人将进一步提升面向大模型的芯片设计能力及面向大模型的软件技术储备等主营业务技术水平，增强公司的技术研发实力，提升产品核心竞争力，促进公司科技创新实力的持续提升。发行人具备必要的独立性，能够按照法律、法规以及监管机构的要求规范运作，主营业务突出，具备良好的发展前景，募集资金用途符合国家产业政策，符合《公司法》《证券法》和《注册管理办法》等有关法律、法规及规范性文件规定的上市公司向特定对象发行 A 股股票的条件，并履行了相关决策程序。

因此，本保荐机构同意保荐寒武纪向特定对象发行 A 股股票。

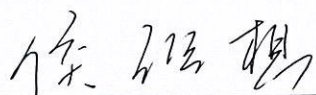
（以下无正文）

（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中科寒武纪科技股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书》之签章页）

保荐代表人：



彭 捷



侯理想

项目协办人：

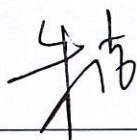


吴智超



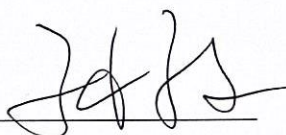
（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中科寒武纪科技股份有限公司
2025 年度向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书》之签章页）

内核负责人：



朱 洁

保荐业务负责人：



孙 毅



（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中科寒武纪科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书》之签章页）

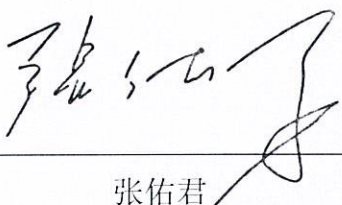
总经理：


邹迎光



（此页无正文，为《中信证券股份有限公司关于中科寒武纪科技股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票之上市保荐书》之签章页）

董事长、法定代表人：


张佑君

